



2026 年 8 月 7 日

各 位

薄型基板内蔵キャパシタ材料「FaradFlex®」生産能力増強

～2030 年に向けて総額 50 億円の投資を行い、既存 2 拠点の増産と台湾新工場設置で生産能力 5 倍へ～

当社（社長 池信省爾）は、マレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.）および上尾事業所にて製造している薄型基板内蔵キャパシタ材料「FaradFlex®」の生産体制について、[2025 年 8 月 21 日付ニュースリリース「薄型基板内蔵キャパシタ材料の生産能力追加増強」](#)にて公表しました通り、生産能力の増強を完了いたしました。

さらに 2030 年度までに、既存工場の増産と台湾に新工場を設置することで、生産能力を 2025 年比 5 倍まで増強する計画を決定したことをお知らせいたします。

当社の FaradFlex®は、各種情報通信機器の高速化・大容量化に向けて大きな課題である通信ノイズを低減する材料として、高性能のルーター・サーバー機器やスーパーコンピュータ向けの高多層基板、スマートフォンに内蔵される MEMS マイクロフォンなどに使用されており、極薄銅箔 MicroThin™や高周波基板用電解銅箔 VSP™ に続く成長製品と位置付けております。足元はスマートフォンおよびワイヤレスヘッドセットなどへの当社品採用率の上昇に加え、特に AI インフラ関連での需要が急増しております。今後も市場の成長が見込めることから、FaradFlex®の生産拠点であるマレーシア工場および上尾事業所の両拠点で生産能力を増強するとともに、台湾に新工場を設置することといたしました。

現在、マレーシア工場と上尾事業所の 2 拠点体制における合算生産能力は、月産 75 千㎡まで増強が完了しておりますが、2030 年度に向けて既存拠点でのさらなる増産と、台湾での新工場設置にともなう 3 拠点での合計投資額は、総額 50 億円を見込んでおります。

これらの施策により生産能力は月産 355 千㎡まで増加いたしますが、今後のさらなる需要拡大に応じた増強も視野に入れ、旺盛な需要に十分対応してまいります。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030 年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で “未来” に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

■ 「FaradFlex®」生産能力 単位：千m²/月（ご参考）

	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度	2030 年度
マレーシア工場	70	80	100	135	135	135
上尾事業所	5	5	35	60	85	85
台湾(新工場)	－	－	－	－	70	135
計	75	85	135	195	290	355

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

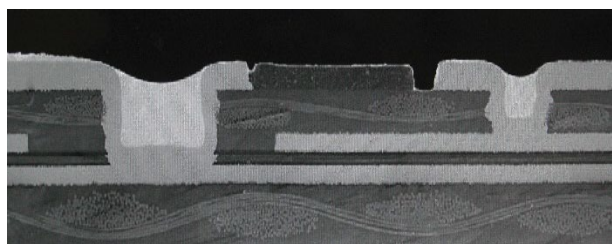
TEL : 03-5437-8028 E-mail : PR@mitsui-kinzoku.com

（ご参考）

1. FaradFlex®の構造

FaradFlex®は、3～25um の極薄絶縁層を銅箔（厚さ 18～70μm）でサンドイッチ状にした構造の材料。基板に内蔵された FaradFlex®で、キャパシタとなる回路を形成する。

FaradFlex®を含むプリント配線板断面図



} FaradFlex®（銅箔／絶縁層／銅箔の3層構造）

2. 基板内蔵キャパシタの使用イメージ

FaradFlex®を使用することで、ICの直下にキャパシタ層を形成することができる。ICとキャパシタ層の距離を縮めることで、通信ノイズを低減することができる。さらに絶縁層が薄いという特徴を有する為、基板の薄型化にも貢献する。

